附件：

会议审定、预审和讨论的标准项目

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 组别 | 计划文号及编号 | 项目名称 | 牵头单位 | 备注 |
|  | 第一组 | 工信厅科函[2022]94号  2022-0108T-YS | 改良西门子法多晶硅用硅芯 | 江苏中能硅业科技发展有限公司 | 审定 |
|  | 国标委发[2021]41号20214647-T-469 | 半导体晶片近边缘几何形态评价 第1部分：高度径向二阶导数法（ZDD） | 山东有研半导体材料有限公司 | 审定 |
|  | 工信厅科函[2022]94号  2022-0110T-YS | 硅片包装和标志 | 浙江海纳半导体有限公司 | 审定 |
|  | 工信厅科函[2022]94号  2022-0111T-YS | 晶片包装片盒表面颗粒的测试 液体颗粒计数法 | 麦斯克电子材料股份有限公司 | 审定 |
|  | 国标委发[2022]17号20220133-T-469 | 埋层硅外延片 | 南京国盛电子有限公司 | 预审 |
|  | 国标委发[2022]17号  20220134-T-469 | 碳化硅外延片 | 南京国盛电子有限公司 | 预审 |
|  | 第二组 | 工信厅科函[2022]94号  2022-0082T-YS | 高纯铟 | 云南锡业集团控股有限责任公司 | 审定 |
|  | 工信厅科函[2022]94号  2022-0083T-YS | 高纯铟化学分析方法 第 1部分：痕量杂质元素含量的测定 辉光放电质谱法 | 国标（北京）检验认证有限公司 | 审定 |
|  | 工信厅科函[2022]158号2022-0574T-YS | 分子束外延（MBE）用高纯铝  源 | 南通泰德电子材料科技有限公司 | 预审 |
|  | 国标委发[2021]28号  20214216-T-469 | III族氮化物半导体材料中位错成像的测试 透射电子显微镜法 | 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 | 讨论 |
|  | 工信厅科函[2022]158号2022-0573T-YS | 半绝缘砷化镓单晶衬底片 | 广东先导微电子科技有限公司 | 预审 |